

HP BladeSystem Administration

HP BladeSystem c-class Enclosure family

Objectives

- Opisać cechy i komponenty fizyczne Bladesystem c-Class
- Wyjaśnić systemy numeracji wnek urządzeń, łączności wnek i wentylatorów
 - Wyjaśnić jak okablować moduł Onboard Administrator

HP BladeSystem c-Class enclosure family

Blade System c3000 Rack and Tower Versions



HP BladeSystem c-Class enclosure family

BladeSystem c7000



BladeSystem c-Class enclosure positioning

C3000 (rack I tower) zdalny oddział i SMB

Najważniejsze różnice:

- ◆ Zajmuje mniej miejsca
- ◆ Rack (6U) i wersja Tower
- ◆ Wybór zasilania
- ◆ Zdolność do pracy w wyższych temperaturach otoczenia
- ◆ Napęd CD/DVD oraz 3-inch LCD Insight Display
- ◆ Wsparcie dla dużych prędkości połączeń I/O
- ◆ Wybór nad zbytecznymi bądź nie-zbytecznymi strukturami

BladeSystem c-Class enclosure positioning

C7000 centra danych

Najważniejsze różnice:

- ◆ Najlepszy stosunek ceny do serwera blade (powyżej 10 blades)
- ◆ Wysoko skalowalny
- ◆ Zoptymalizowany pod kątem zarządzania narzędziami do BladeSystem
- ◆ Zoptymalizowany pod kątem większych centrów danych
- ◆ 220V jedno I trzy fazowe zasilanie
- ◆ Do 4 redundantnych struktur

BladeSystem c-Class enclosure positioning

Cechy wspólne systemów BladeSystem c3000 i c7000:

- ◆ Takie same wentylatory
- ◆ Takie same opcje połączeń
- ◆ Takie same HH i FH
- ◆ Wsparcie wspólnych mezzanines
- ◆ Takie samo wsparcie przechowywania danych blade

C7000 Enclosure - front

C7000 Obudowa - przód



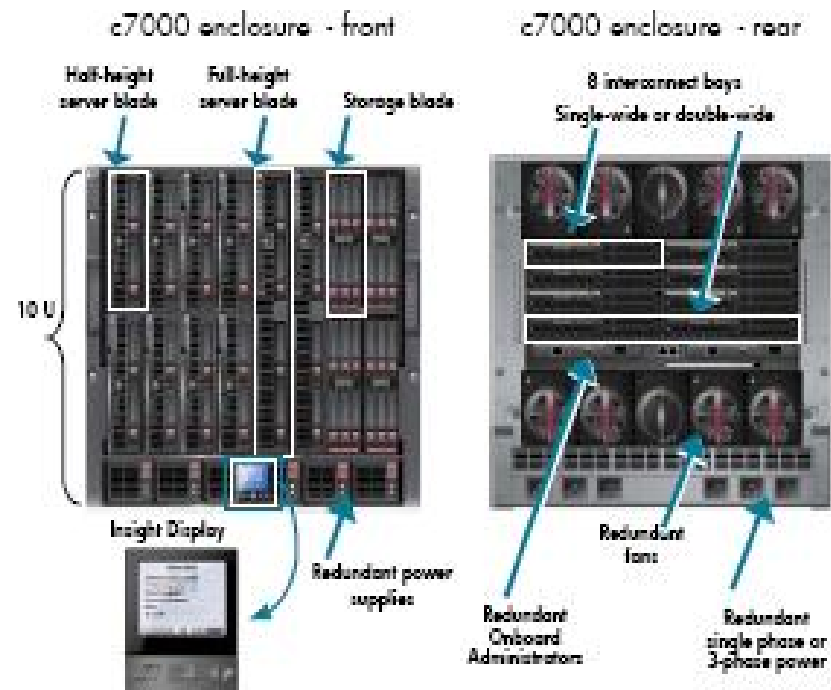
C7000 Enclosure - rear

C7000 Obudowa - tył



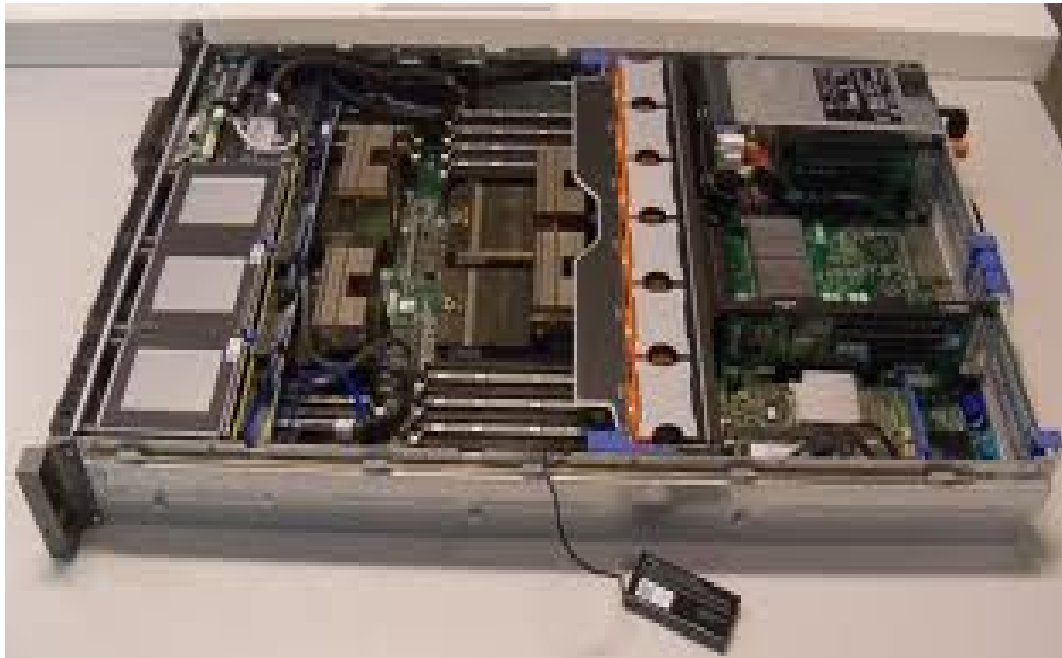
C7000 Enclosure

◆ C7000 obudowa



C7000 Enclosure - inside

C7000 Obudowa - wewnątrz



C3000 Enclosure - front

- ◆ C3000 obudowa - przód



HP BladeSystem c3000 Enclosure



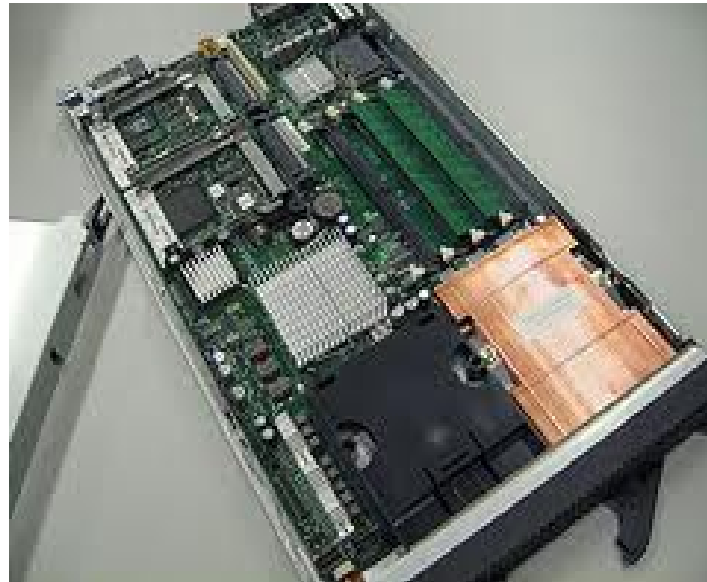
C3000 Enclosure - rear

- ◆ C3000 obudowa - tył



C3000 Enclosure - inside

- ◆ C3000 obudowa - wewnątrz



BladeSystem hot and cold air

- ◆ Ciepłe i zimne powietrze w obudowie BladeSystem

